

平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月14日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社アバールデータ

コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 嶋村 清

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部部長

(氏名) 大関 拓夫

TEL 042-732-1000

四半期報告書提出予定日 平成24年2月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	4,858	△9.0	337	△31.4	394	△30.1	268	△31.5
23年3月期第3四半期	5,339	80.6	492	—	564	—	391	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 194百万円 (303.4%) 23年3月期第3四半期 48百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	44.98	—
23年3月期第3四半期	52.91	52.72

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第3四半期	9,422	8,127	79.3
23年3月期	9,718	8,050	76.1

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 7,476百万円 23年3月期 7,396百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	8.00	—	12.00	20.00
24年3月期	—	11.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	10.00	21.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	6,800	△3.5	550	△11.9	600	△13.9	430	△13.3	72.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
- ② ①以外の会計方針の変更 ： 無
- ③ 会計上の見積りの変更 ： 無
- ④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

24年3月期3Q	8,064,542 株	23年3月期	8,064,542 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

24年3月期3Q	2,065,504 株	23年3月期	2,112,748 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

24年3月期3Q	5,968,280 株	23年3月期3Q	7,408,210 株
----------	-------------	----------	-------------

(注)当社は当連結会計年度より、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる信託口が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において24年3月期3Qの自己株式として表示していることから、当該信託口が所有する当社株式数については、24年3月期3Qの「期末自己株式数」に265,100株を含めており、「期中平均株式数（四半期累計）」から291,177株を控除しております。
なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】4ページ(3)追加情報に記載しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(3) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 補足情報	10
(1) 生産、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動や経済活動の停滞は回復基調にあるものの、円高水準の長期化や株価低迷、欧州財政危機の深刻化による世界経済の減速により、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、世界経済の不透明感に加え、従来型PC及び薄型テレビの低迷により、半導体製造装置関連製品の需要が減少しております。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、市場ニーズを先取りした新製品の投入によりお客様の装置の進化に貢献するとともに、省電力の設備導入と生産性向上で環境に優しいモノ作りを実現、品質面では業界水準を越える品質の確保、さらに社内の業務プロセスを見直すことにより、収益性の向上に取り組みました。

この結果、第3四半期連結累計期間における売上高は4,858百万円（前年同四半期比9.0%減）、営業利益は337百万円（前年同四半期比31.4%減）、経常利益は394百万円（前年同四半期比30.1%減）、四半期純利益は268百万円（前年同四半期比31.5%減）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第3四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売を行っております。大手半導体メーカーの設備投資が再開されましたが、本格的な回復に至っておらず、売上高は減少しております。

この結果、売上高は3,244百万円（前年同四半期比13.0%減）、セグメント営業利益は441百万円（前年同四半期比20.2%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーのLSI微細化が続く中、最先端の半導体製造装置への設備投資が再開されましたが、半導体製造装置関連製品全体の本格的な回復に至っておらず、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は2,164百万円（前年同四半期比17.0%減）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。産業用装置の受注は堅調に推移しましたが、社会インフラ関連が引き続き低迷し、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は569百万円（前年同四半期比12.9%減）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。主力の電力関連機器全般の回復に加え、各種計測機器の受注が堅調に推移し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は510百万円（前年同四半期比9.3%増）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュール及び計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器及びソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。第3四半期に入り設備投資の停滞により、自社製品全般の受注は調整局面に入っております。

この結果、売上高は1,614百万円（前年同四半期比0.3%増）、セグメント営業利益は278百万円（前年同四半期比3.1%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般及び半導体製造装置関連の受注が減少したため、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は474百万円（前年同四半期比12.7%減）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。第3四半期に入りFA全般及び液晶関連装置が低迷しましたが、新製品の立ち上がりに加え新分野での営

業開拓が順調に進みました。

この結果、売上高は472百万円（前年同四半期比4.0%増）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI（Computer Telephony Integration）・リモート監視機器及びスマート電源装置を提供しております。順調な超高速シリアル通信モジュールに加えCTIが回復局面に転じ、更に新規事業であるスマート電源装置の立ち上がりにより、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は567百万円（前年同四半期比19.2%増）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェア及び付属の周辺機器を提供しております。大口受注の減少により、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は100百万円（前年同四半期比26.2%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産は9,422百万円（前連結会計年度末比295百万円の減少）となりました。

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が35百万円増加、受取手形及び売掛金が150百万円減少、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品これらのたな卸資産が63百万円増加、その他が21百万円減少した結果、73百万円減少し5,986百万円となりました。固定資産につきましては、主に、有形固定資産が44百万円減少、無形固定資産が1百万円増加、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動等の影響により178百万円減少した結果、222百万円減少し3,436百万円となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債は1,295百万円（前連結会計年度末比373百万円の減少）となりました。

流動負債につきましては、主に、原材料等の仕入減少に伴い支払手形及び買掛金が259百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が34百万円増加、未払法人税等が161百万円減少、賞与引当金が66百万円減少、役員賞与引当金が2百万円減少、その他が預り金の増加等により29百万円増加した結果、426百万円減少し807百万円となりました。固定負債につきましては、主に、長期借入金が153百万円増加、役員退任による取崩しで役員退職慰労引当金が6百万円減少、その他が繰延税金負債の減少等により96百万円減少した結果、全体で53百万円増加し487百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産は8,127百万円（前連結会計年度末比77百万円の増加）となりました。

主に、利益剰余金が128百万円増加、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入により資本剰余金及び自己株式にて30百万円増加、その他有価証券評価差額金が78百万円減少、少数株主持分が2百万円減少したことが要因となります。

(自己資本比率)

当第3四半期連結会計期間末における自己資本比率は79.3%（前連結会計年度末比3.2ポイント増加）となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、平成23年9月13日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に公表いたしました業績予想及び配当予想と同様です。

なお、本資料に記載した業績予想等は、概ね計画通りに推移しており、平成23年9月13日に公表した数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はございません。

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日）を適用しております。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の金額は、52円71銭であります。

- (3) 追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について）

当社は、平成23年5月25日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしました。

割当先である野村信託銀行株式会社「アパールグループ社員持株会専用信託口」（以下「信託口」といいます。）は、当社と野村信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。）を締結することによって設定された信託口であります。

本プランでは、信託口が、本信託の設定後6年間にわたりアパールグループ社員持株会（以下「本持株会」といいます。）が取得すると合理的に見込まれる数の株式会社アパールデータ株式を、金融機関からの借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を株式会社横浜銀行、借入人を信託口、保証人を当社とする三者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。

信託口が取得した当社株式は、本持株会と締結される株式注文契約に基づき、信託期間（6年）において、毎月、その時々で売却いたします。

本信託では、当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を借入金の返済及び金利の支払いに充当いたします。本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭を、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす社員に分配いたします。なお、当社は信託口が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落等により本信託の終了時点において借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証履行いたします。

当社は平成23年6月22日付で、自己株式312,400株を信託口へ譲渡しております。当該自己株式については、当社から信託口へ株式を譲渡した時点で売却処理を行っております。また、信託口が所有する株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と信託口は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて処理しております。なお、信託口が所有する株式については自己株式として表示しており、当第3四半期連結会計期間末において、信託口が所有する当社株式数は、265,100株となっております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,525,982	2,561,658
受取手形及び売掛金	1,415,103	1,264,520
有価証券	10,149	10,155
商品及び製品	396,204	474,171
仕掛品	375,709	381,689
原材料及び貯蔵品	744,465	724,068
その他	591,931	570,190
流動資産合計	6,059,547	5,986,454
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	965,591	920,847
有形固定資産合計	2,282,290	2,237,547
無形固定資産	57,988	59,066
投資その他の資産		
投資有価証券	1,260,718	1,082,361
その他	88,730	88,012
貸倒引当金	△30,533	△30,453
投資その他の資産合計	1,318,915	1,139,920
固定資産合計	3,659,194	3,436,534
資産合計	9,718,742	9,422,989
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	705,624	446,528
1年内返済予定の長期借入金	—	34,000
未払法人税等	187,302	25,535
賞与引当金	162,607	96,110
役員賞与引当金	14,660	11,739
その他	163,838	193,513
流動負債合計	1,234,031	807,426
固定負債		
長期借入金	—	153,520
退職給付引当金	94,687	97,002
役員退職慰労引当金	77,030	70,672
その他	262,724	166,571
固定負債合計	434,442	487,766
負債合計	1,668,474	1,295,192

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,456,077	2,446,534
利益剰余金	3,562,149	3,690,277
自己株式	△1,420,923	△1,381,042
株主資本合計	6,951,397	7,109,863
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	445,527	366,789
その他の包括利益累計額合計	445,527	366,789
少数株主持分	653,343	651,143
純資産合計	8,050,268	8,127,796
負債純資産合計	9,718,742	9,422,989

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
売上高	5,339,211	4,858,916
売上原価	3,646,194	3,223,297
売上総利益	1,693,017	1,635,619
販売費及び一般管理費	1,200,451	1,297,704
営業利益	492,565	337,914
営業外収益		
受取利息	1,703	883
受取配当金	61,186	48,397
その他	9,142	8,266
営業外収益合計	72,031	57,547
営業外費用		
支払利息	—	723
為替差損	1	1
支払手数料	—	227
営業外費用合計	1	951
経常利益	564,595	394,510
特別利益		
固定資産売却益	300	98
投資有価証券売却益	70,594	46,296
その他	90	—
特別利益合計	70,984	46,394
特別損失		
固定資産売却損	—	15
固定資産除却損	65	3,406
特別損失合計	65	3,422
税金等調整前四半期純利益	635,514	437,482
法人税、住民税及び事業税	119,264	111,927
法人税等調整額	104,163	52,549
法人税等合計	223,427	164,476
少数株主損益調整前四半期純利益	412,086	273,006
少数株主利益	20,141	4,550
四半期純利益	391,945	268,455

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	412,086	273,006
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△363,926	△78,738
その他の包括利益合計	△363,926	△78,738
四半期包括利益	48,160	194,267
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	28,019	189,717
少数株主に係る四半期包括利益	20,141	4,550

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第3四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日）

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

I 前第3四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日）

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	3,729,553	1,609,658	5,339,211
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	3,729,553	1,609,658	5,339,211
セグメント利益	554,111	287,136	841,248

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	841,248
セグメント間取引消去	—
全社費用（注）	△348,682
四半期連結損益計算書の営業利益	492,565

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

II 当第3四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日）

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	3,244,318	1,614,598	4,858,916
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	3,244,318	1,614,598	4,858,916
セグメント利益	441,998	278,116	720,115

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	720,115
セグメント間取引消去	—
全社費用（注）	△382,201
四半期連結損益計算書の営業利益	337,914

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第3四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日）

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	1,939,387	119.3	1,635,098	△15.7
産業用制御機器	532,616	21.8	431,329	△19.0
計測機器	336,890	7.1	368,558	9.4
小計	2,808,895	71.7	2,434,985	△13.3
自社製品				
組込みモジュール	328,221	171.9	268,074	△18.3
画像処理モジュール	204,912	89.1	234,377	14.4
計測通信機器	191,129	9.2	282,507	47.8
小計	724,263	79.2	784,959	8.4
合計	3,533,159	73.2	3,219,945	△8.9

(注) 1 金額は製造原価にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	117,008	120.8	81,319	△30.5
合計	117,008	120.8	81,319	△30.5

(注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	2,398,192	85.5	2,154,691	△10.2
産業用制御機器	640,366	15.0	530,843	△17.1
計測機器	472,664	7.7	524,016	10.9
小計	3,511,223	53.4	3,209,552	△8.6
合計	3,511,223	53.4	3,209,552	△8.6

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	255,467	△11.2	457,786	79.2
産業用制御機器	212,856	19.2	118,234	△44.5
計測機器	140,444	15.5	161,111	14.7
小計	608,768	3.5	737,132	21.1
合計	608,768	3.5	737,132	21.1

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	2,608,815	143.4	2,164,524	△17.0
産業用制御機器	654,144	22.3	569,693	△12.9
計測機器	466,592	22.0	510,099	9.3
小計	3,729,553	87.5	3,244,318	△13.0
自社製品				
組込みモジュール	543,082	129.6	474,261	△12.7
画像処理モジュール	454,722	94.1	472,728	4.0
計測通信機器	475,945	10.2	567,311	19.2
自社製品関連商品	135,908	109.7	100,297	△26.2
小計	1,609,658	66.4	1,614,598	0.3
合計	5,339,211	80.6	4,858,916	△9.0

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 受注高及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。